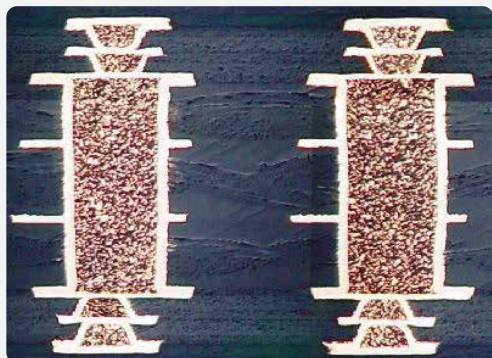


# 基板向け導電性ペースト

民生機器から産業機器まで、幅広い用途に対応

## 用途

### 放熱・層間接続用途



基板断面イメージ

民生機器

イメージ：SSD



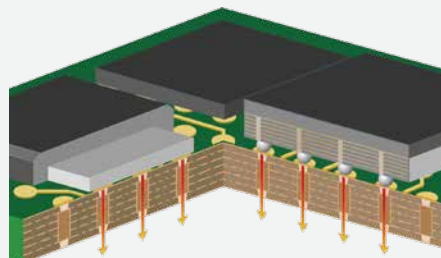
通信機器

イメージ：  
光トランシーバー



## 特徴

- 各種基材や銅箔と優れた密着性
- 安定した導電性
- 高い放熱性 (AE7332 - 熱伝導性 38W/m・k)
- 溶剤不使用のため、ポイドの発生を抑制
- 基板の高密度実装やビルドアップ化に貢献
- 豊富なラインナップ！用途に合わせ選択可



放熱イメージ

## ラインナップ&特性

製品型番			AE1244	AE2217	AE1650	AE3030	AE7332
粘度	BH型	dPa・s	800 ~ 1,400	1,600 ~ 2,200	1,300 ~ 1,800	1,200 ~ 1,800	900 ~ 1,500
硬化条件	予備加熱		80°C×30分	60°C×30分	80°C×30分	60°C×30分	80°C×30分
	本硬化		160°C×60分				
体積抵抗率[代表値]		Ω・cm	1.0E-04			2.0E-04	5.00E-05
熱伝導性 (レーザーフラッシュ法)		W/m・k	11.7	13.5	16.5	7.8	38
ガラス転移温度 (DMA)		°C	110	113	95	171	56

